Produktdatenblatt Eigenschaften

BMEP585040C

Modicon M580 CPU-Modul, 5040 Level 5 DIO + RIO, 24 MB, 61 Eth-Geräte, 31 Rem.E/A-Racks, (X80 & Quantum) Schutzlackierung





Hauptmerkmale

| Baureihe | Modicon M580 |
|---------------------------------|-------------------|
| Produkt- oder Komponententyp | Prozessormodul |
| Imprägnierungsmaterial | Schutzbeschichtet |

Zusatzmerkmale

| Anzahl von Racks | 8 |
|--|---|
| Lokale E / A-Prozessorkapazität (diskret) | 5120 E/A |
| Lokale E / A-Prozessorkapazität (analog) | 1.280 E/A |
| Anzahl der anwendungsspezifischen Kanäle (lokales Gestell) | 180 |
| Anwendungspezifischer E/A | Genaue Zeitstempelung Motion Control Serielle Schnittstelle HART SSI-Encoder Zähler |
| Prüfungen | Prozesssteuerung |
| Steuerkanäle | Programmierbare Regelkreise |
| Integrierte Verbindungsart | 1 Ethernet TCP/IP für Service-Port 2 Ethernet TCP/IP für Gerätenetzwerk USB Typ Mini-B |
| Anzahl entfernter E/A-Stationen | 31 - 2 Einbaugehäuse pro Remote-Station (RIO drop) |
| Anzahl verteilter Geräte | 64 |
| Kapazität des Kommunikationsbaustein-Prozessors | 8 AS-Interface-Modul 6 Ethernet-Kommunikationsmodul |
| Kommunikationsdienst | RIO-Scanner DIO-Scanner |
| Speicherbeschreibung | Erweiterbar Flash, 4 GB für Datenspeicherung Integriert RAM, 10 KB für Systemspeicher Integriert RAM, 24 MB für Programm Integriert RAM, 4096 kB für Daten |
| Anwendungsstruktur | 1 periodische Fast Task 2 Hilfs-Tasks 128 Ereignis-Tasks 1 zyklisch/periodische Master Task |
| Anzahl der Anweisungen pro ms | 40 kAnw/ms 100 % boolesch 60 Kinst/ms 65% boolesch + 35% fest-arithmetisch |
| Stromaufnahme | 300 mA bei 24 V DC |
| MTBF Zuverlässigkeit | 775000 H |
| Beschriftung | CE |

Montage

| Montage | |
|----------------------------------|--|
| Vibrationsfestigkeit | 3 gn |
| Stoßfestigkeit | 30 gn |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -2560 °C |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -4085 °C |
| Betriebshöhe | 0 - 2.000 m 2000 - 5000 m mit Leistungsminderungsfaktor |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 595 % bei 55 °C ohne Kondensation |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Richtlinien | 2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit 2014/34/EU - ATEX-Richtlinie |
| Produktzertifizierungen | CE[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]Handelsmarine[RETZone 2/22[RETURN]IECEx Zone 2/22 |
| Normen | EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, Interface Typ 1 und Type 2 EN/IEC 61850-3, Standort G EN/IEC 60079-0 |
| Umgebungseigenschaften | Gasbeständig Klasse Gx entspricht ISA S71.04 Gasbeständig Klasse 3C4 entspricht IEC 60721-3-3 Staubbeständig Klasse 3S4 entspricht IEC 60721-3-3 Sandbeständigkeit Klasse 3S4 entspricht IEC 60721-3-3 Salzbeständig Level 2 entspricht IEC 68252 Spritzgussbeständigkeit Klasse 3B2 entspricht IEC 60721-3-3 Pilzsporen-resistent Klasse 3B2 entspricht IEC 60721-3-3 Gefahrenbereich Klasse I Division 2 |
| Beschichtung | Schutzlack |
| Versorgung | Interne Stromversorgung über Modulträger |
| LED-Statusanzeige | 1 LED (grün) Prozessor in Betrieb (RUN) 1 LED (rot) Prozessor- oder Systemfehler (ERR) 1 LED (rot) I/O Modulfehler (I/O) 1 LED (grün) Downloadvorgang aktiv (DL) 1 LED (rot) Speicherkarten- oder CPU-Flash-Fehler (BACKUP) 1 LED (grün/rot) ETH MS (Konfigurationsstatus Ethernet-Schnittstellen) 1 LED (grün/rot) Eth NS (Ethernet-Netzwerkstatus) 1 LED (grün) E/A-Werte durch Nutzer überschrieben (FORCED IO) |
| Produktgewicht | 0,849 kg |
| Verpackungseinheiten | |
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 8,500 cm |
| VPE 1 Breite | 17,500 cm |
| VPE 1 Länge | 25,000 cm |
| VPE 1 Gewicht | 883,000 g |
| VPE 2 Art | S03 |
| VPE 2 Menge | 6 |
| VPE 2 Höhe | 30,000 cm |
| VPE 2 Breite | 30,000 cm |
| VPE 2 Länge | 40,000 cm |
| VDE 0.0 - 1-1-1 | F 700 L . |

5,730 kg

VPE 2 Gewicht

Nachhaltigkeit

| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
|-------------------------------------|---|
| REACh-Verordnung | ☑ REACh-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | ☑ RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | ₫Ja |
| Umweltproduktdeklaration | ☑ Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | ☑ Entsorgungsinformationen |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

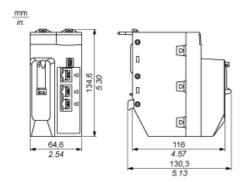
Vertragliche Gewährleistung

| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|
| | |

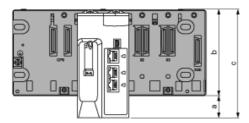
Produktdatenblatt Maßzeichnungen

BMEP585040C

Nur CPU-Module

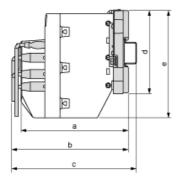


Auf Racks montierte Module



- a: Zusätzlicher Abstand unter dem Rack zur Berücksichtigung der Höhe der CPU. X Bus-Rack: Der Abstand beträgt 30,9 mm (1.217 in.)Ethernet-Rack: Der Abstand beträgt 29,49 mm (1.161 in.)
- b: Die Höhe des Racks. Für ein X Bus-Rack beträgt die Höhe 103,7 mm (4.083 in.); für ein Ethernet-Rack beträgt die Höhe 105,11 mm (4.138 in.).
- c: Die Höhe des lokalen Hauptracks, 134,6 mm (5.299 in.)

In ein Gehäuse montierte Module und Kabel



- a: Gehäusetiefe: 135 mm (5.315 in.)
- b: Tiefe Verdrahtung + Modul: > 146 mm (5.748 in.)
- c: Verdrahtung + Modul + DIN-Schienentiefe: > 156 mm (6.142 in.)
- d: Rackhöhe: X Bus-Rack 103,7 mm (4.083 in.); für ein Ethernet-Rack, 105,11 mm (4.138 in.)
- e: Modulhöhe: 134,6 mm (5.299 in.)